

晶粒等級圖案定義對準系統

注意事項

V2019/04/01

1. 機台開放等級為 B2 級，是為服務各型計畫使用/自行操作人員限制：同一實驗室碩士班學生不得超過二人、博士班學生不限。
2. 於上班時段（上午 8：00 至下午 6：00）TSRI 員工有優先使用權。如欲在上班時段使用機台，必須先徵求在場 operator 同意之後，方可使用；若現場無 operator，則可先行使用，但於使用中若 operator 出現且欲使用機台，operator 有權要求使用者中止使用。
3. 委託操作服務/自行操作使用者皆請自備光罩及晶圓。
4. 可用光罩標準尺寸：□5”、□7”、□9”。
5. 可用試片標準尺寸： ϕ 4”、 ϕ 6”、 ϕ 8”、□12mm、□25mm、□40mm、□50mm。
6. 6”/8” track 使用標準光阻：PFI38 正型光阻，厚度 1 μ m。
7. 欲使用非標準尺寸之光罩、試片或光阻，請提出相關書面說明，經核准後，方可使用。
8. 作業過程中，光罩必定會接觸試片，有可能因此造成光罩/試片髒污或損壞，敬請使用者理解，並自行負責。
9. 有造成機台損壞或是汙染風險之委託操作服務，負責工程師得以要求委託者改善，如仍無法改善，拒絕接受委託。
10. 有造成機台損壞或是汙染風險之自行操作，負責工程師得以中止其自行操作。
11. recipe 命名規則：學校系所_實驗室名稱_光罩名稱_第 1 層/第 2 層以後。
 - (Ex.: TSRI_litho_mask1_1st 或 NCTU_Linlab_MOS2_2nd)
12. 請務必遵守使用規則：僅用屬於自己的 recipe，不動不屬於自己的 recipe。
13. recipe 內容請自行牢記，TSRI 不負記憶 recipe 之責任。
14. 機台每年 2 月及 8 月進行曝光檔案清理，使用者請於 1 月底及 7 月底前將欲保留的檔案名稱列表繳交機台負責人，若因未繳交或是表列遺漏以致檔案遭刪除，使用者請自負責任，不得異議。
15. 曝多層圖形，請先製作對準標記。
 - 選用正型阻劑 PFI38
 - TSRI 提供 3 張 5”光罩，為標準版本零層光罩，分別對應 ϕ 4” 試片正-正/正-反對準曝光、 ϕ 6” 試片正-正/正-反對準曝光、 ϕ 8”試片正-正/正-反對準曝光，□12mm 試片正-正對準曝光、以及□25mm 試片正-正對準曝光。詳情可見網頁標準製程 L20-C 內容說明。
 - 蝕刻深度依製程而異，建議約為 600 nm。